



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

Global Family,
Global Solutions!

環球晶圓 (6488TT)

2024 年第一季營運報告

2024年05月





Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.



01

經營團隊重點報告



經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

● 營業收入

- ✓ 2024年第一季 → 新台幣 150 億元，年減 19%。
- ✓ 即使總體經濟遭遇逆風，環球晶圓自2024年1月起，仍連續兩個月正成長！

2024 (單位: 新台幣百萬元)	一月	MoM	二月	MoM	三月
營業收入	4,396	14.40%	5,029	12.59%	5,662

● 營業毛利率

- ✓ 2024年第一季 → 34.3%

● 營業淨利率

- ✓ 2024年第一季 → 26.3%



➤ 財務摘要

● 稅後淨利率

✓ 2024年第一季 → 23.4%

● 每股盈餘

✓ 2024年第一季 → 新台幣 8.10 元

● 預收貨款

✓ 新台幣 350.3 億元 (美金 10.1 億元)¹

● 股利發放計畫

✓ 2023年全年股利：新台幣 19 元

(2023年上半年：新台幣 8 元；2023年下半年：新台幣 11 元)

✓ 2023年全年股利配發率：41.8 %

✓ 除息基準日：2024/07/24

✓ 股利配發日：2024/08/16

備註：

1. 換算匯率：NTD:USD = 32.00, 含保證金



➤ 產業概況

● 全球經濟

- ✓ 根據國際貨幣基金組織預測，2024年、2025年全球經濟成長率將分別穩定增長3.2%，與2023年成長率相當，顯示全球總體經濟仍具備韌性。
- ✓ 儘管具潛在通貨膨脹風險，受消費者信心改善和全球GDP成長影響，全球採購經理人指數 (PMI) 持續攀升，普遍呈現上升趨勢。

● 半導體市場

- ✓ 人工智慧應用熱潮及記憶體需求湧現，成為半導體產業成長的關鍵驅動力，伴隨客戶稼動率逐步提升，整體庫存水位可望逐漸回歸健康。預計2024年下半年整體表現將優於上半年，惟仍需關注降息步調、油價、電動車需求放緩等不確定因素。
- ✓ 環球晶圓對焦市場趨勢，大幅增加先進製程專用的優質晶圓產品佔比，並於具備成長動能的區域啟動擴產計畫，因應不斷增長的先進製程需求。



➤ 產業概況

● 永續經營策略

- ✓ 環球晶圓以全球廣泛布局所帶來的**就近地緣**與**永續環保**脫穎而出，致力於減少自身碳足跡，採用各區域的綠色能源方案，積極應對氣候變遷，同時為客戶提供永續解決方案，實際行動體現於為現有擴廠計畫導入綠色能源：
 - **丹麥**：將於2024年下半年成為**首座使用自發自用100%綠電的半導體長晶工廠**。
 - **義大利**：新擴建之12吋生產線預計於2025年量產階段使用**100%綠電**。
 - **美國**：預計於2025年量產階段使用**100%綠電**。
- ✓ 透過就近供應客戶需求，環球晶圓可最小化運輸距離，從而降低自身碳排，並減緩地緣政治風險，提升永續經營績效。

● 地震影響

- ✓ 儘管四月三日於台灣發生之地震影響部分長晶爐，受益於提前備貨充足矽晶棒庫存，經檢視後各產線運作皆順利恢復，對公司營收影響甚微。



➤ 其他

● 公司治理評鑑

- ✓ 根據第十屆公司治理評鑑結果，環球晶圓**連續六年**榮獲**公司治理評鑑上櫃類排名前百分之五**，體現環球晶圓持續精進公司治理成效，強化公司治理藍圖並實踐企業永續之優異成果。



02

產業概況



永續經營策略

- 環球晶圓優先採取在地化供應策略，以降低運輸成本、減少碳排放，同時減緩地緣政治風險，展現有效風險管理和永續經營。

永續經營方案



丹麥
(Topsil)

➤ 再生能源使用承諾

環球晶圓旗下丹麥廠 **Topsil GlobalWafers A/S** 預計在**2024年下半年**成為**首座使用自發自用100%綠電**的半導體長晶工廠。



義大利
(S.p.A.)

➤ 再生能源使用承諾

環球晶圓旗下義大利廠 **MEMC Electronic Materials S.p.A.** 在**2025年**新擴建之12吋生產線，將於量產階段**使用100%綠電**。



美國
(GWA)

➤ 再生能源及回收用水使用承諾

環球晶圓旗下美國廠 **GlobalWafers America LLC** 是規模最大之12吋矽晶圓綠地**(Greenfield)** 投資案，將於量產階段**回收超過一半之生產用水**，並**使用100%再生能源**生產世界最先進的矽晶圓。



12吋矽晶圓工廠設備投資展望

- 預計全球12吋矽晶圓廠設備投資將於2025年增加20%，達1,165億美元，2026年增加12%至1,305億美元，並於2027年達到歷史新高。
- 受惠於人工智慧、汽車及智慧邊緣裝置需求增加，晶圓代工市場增長幅度位居首位，記憶體市場則位居第二，進而帶動12吋矽晶圓廠的設備投資，以滿足相關市場需求。



環球晶圓所有資本支出
皆用於先進製程

➤ 大尺寸矽晶圓

- 12" PW - 12" EPI

➤ 特殊尺寸矽晶圓

- 8" FZ - 12" SOI

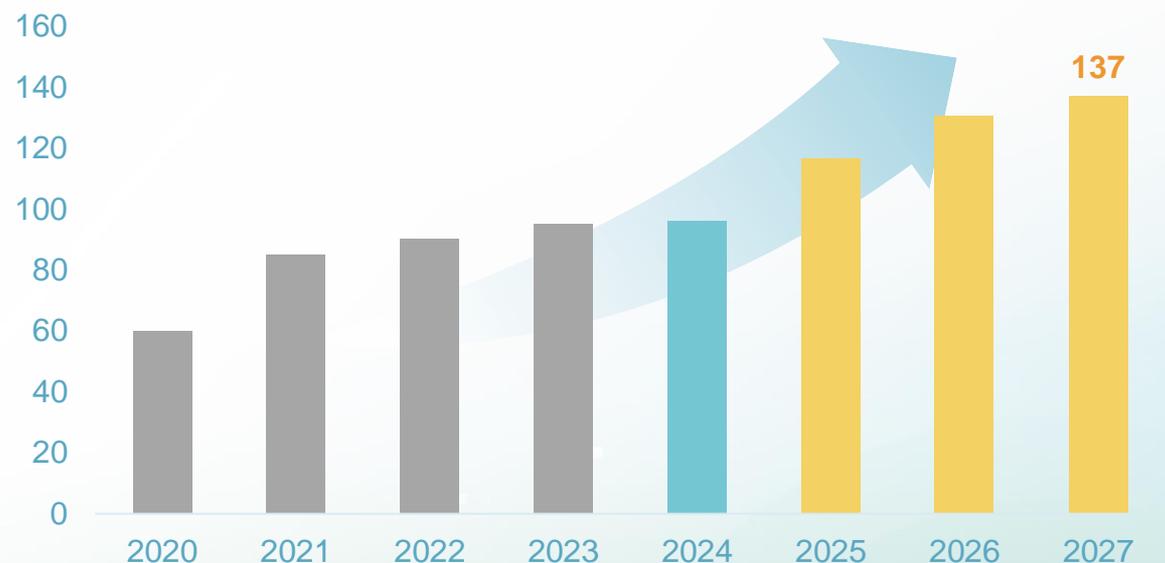
➤ 化合物半導體材料

- SiC - SiC EPI

- GaN on Si

未來12吋矽晶圓廠設備支出預測

(單位: 美金十億元)



歷史新高!

半導體擴產地區分布

➤ 環球晶圓擴產計畫遍及亞洲、美國及歐洲等地區，與世界半導體設備製造商擴產地區一致。

環球晶圓擴產地區

亞洲



美國



歐洲



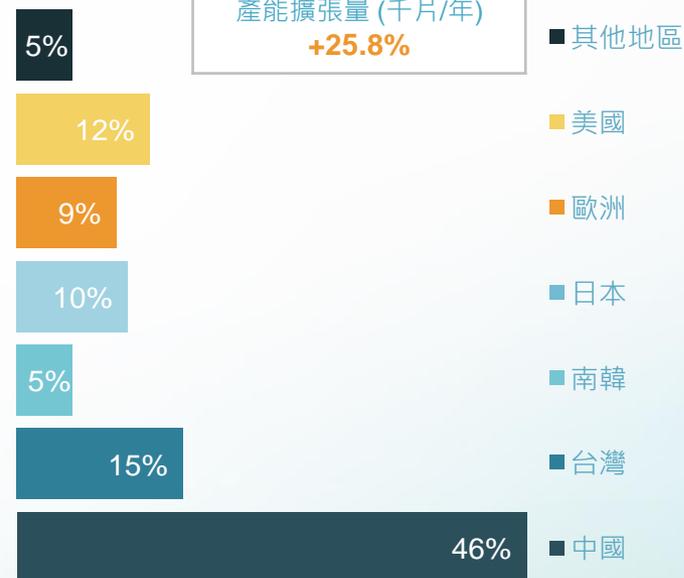
各地區半導體擴產分布

12吋矽晶圓廠產能(千片/年) · 跨節點尺寸, 不含記憶體

(總擴產量占比)

2023-2027

產能擴張量 (千片/年)
+25.8%





GlobalWafers America (GWA) : 美國12吋矽晶圓擴廠計畫

- 環球晶圓旗下GWA¹12吋矽晶圓工廠興建進度如期進行，並已提交晶片法案(CHIPS ACT)完整申請文件，目前正與美國商務部的晶片計畫辦公室(CHIPS Program Office, CPO)商討相關補助金額。



美國本土**唯一先進晶圓製造商**



計畫於量產階段**100%使用再生能源**



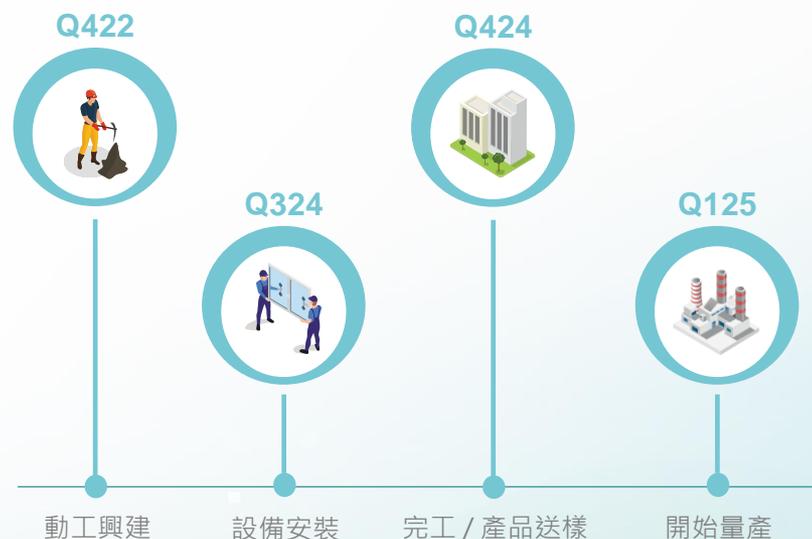
為美國最大，亦為全球**最大的矽晶圓廠**



施工團隊工作時數已超越**120萬小時**，且**無任何損失工時傷害事故發生**，使該興建案成為**美國最安全的大型建設項目之一**。

GWA 進程

美國廠預計將成為**唯一美國本土製造的12吋先進矽晶圓工廠**



備註:
1. 指位於德州謝爾曼市(Sherman, Texas)美國環球晶圓(GlobalWafers America)之綠地投資案(Greenfield)

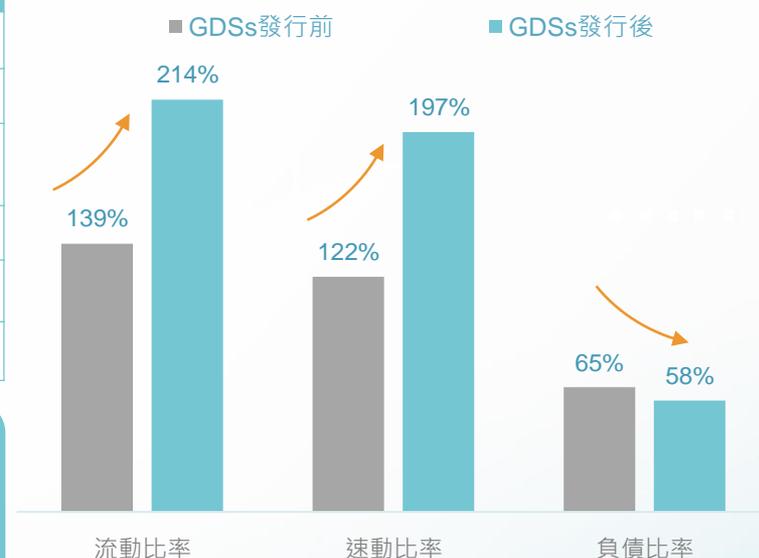


公司透過低成本資金支應未來資本支出

- 環球晶圓透過發行公司債(CB¹)、海外可轉債(ECB²)、海外附認股權公司債(Exchangeable Unit)及海外存託憑證(GDSs³)等籌資管道，獲取低成本資金以因應未來資本支出，從而避免受利率波動影響，確保公司長期發展。

環球晶圓資金來源	金額	利率	到期日
公司債 #1	新台幣 65 億	0.62%	2026
公司債 #2	新台幣 125 億	0.5% / 0.6%	2024 / 2026
海外可轉債	美金 10 億	-0.25%	2026
海外附認股權公司債	歐元 3.45 億	1.50%	2029
公司債 #3	新台幣 50 億	1.7% / 1.75%	2029 / 2031
海外存託憑證	美金 6.89 億	-	-

GDSs發行前後財務比率變化假設⁵



> 10億
美元

環球晶圓於2024年第一季⁴籌措**超過10億美元**低成本資金，以支持公司長期發展。

75%

可動用銀行融資額度*
(截至 2024年3月)

*融資額度: 含銀行保證額度

- 環球晶圓具備充足可動用銀行融資額度，可替未來幾年之資本支出提供充沛的資金來源。

備註:
1. CB = Corporate Bond
2. ECB = Euro Convertible Bond
3. GDSs = Global Depository Shares
4. 環球晶圓於2024年第一季籌資內容包含海外附認股公司債、公司債 #3及海外存託憑證
5. GDSs資金實際於2024年4月到帳，在此模擬於2024年第一季度到帳



03

營運概況



財務摘要：2024年第一季 vs. 2023年第四季 vs. 2023年第一季

(單位: 新台幣百萬元, 除每股盈餘)	2024年第一季	2023年第四季	2023年第一季	季成長	年成長
營業收入	15,087	16,763	18,616	-10.0%	-19.0%
營業毛利 %	34.3%	34.5%	40.6%	-0.2 ppt	-6.3 ppts
營業淨利	3,968	3,921	6,103	1.2%	-35.0%
營業淨利 %	26.3%	23.4%	32.8%	2.9 ppts	-6.5 ppts
本期淨利	3,533	4,442	5,000	-20.5%	-29.3%
本期淨利 %	23.4%	26.5%	26.9%	-3.1 ppts	-3.5 ppts
每股盈餘 ¹	NT\$8.10	NT\$10.19	NT\$11.49	-NT\$2.09	-NT\$3.39
EBITDA* ²	5,882	6,808	7,907	-13.6%	-25.6%
EBITDA %	39.0%	40.6%	42.5%	-1.6 ppts	-3.5 ppts
EBIT ³	4,025	5,028	6,302	-19.9%	-36.1%
股東權益報酬率 / ROE* ⁴ (年化)	20.5%	26.8%	35.6%	-6.3 ppts	-15.1 ppts
資產報酬率 / ROA* ⁵ (年化)	7.5%	9.8%	11.8%	-2.3 ppts	-4.3 ppts
資本支出 ⁶	10,438	12,573	5,116	-	-
折舊費用	1,852	1,774	1,601	-	-

備註:

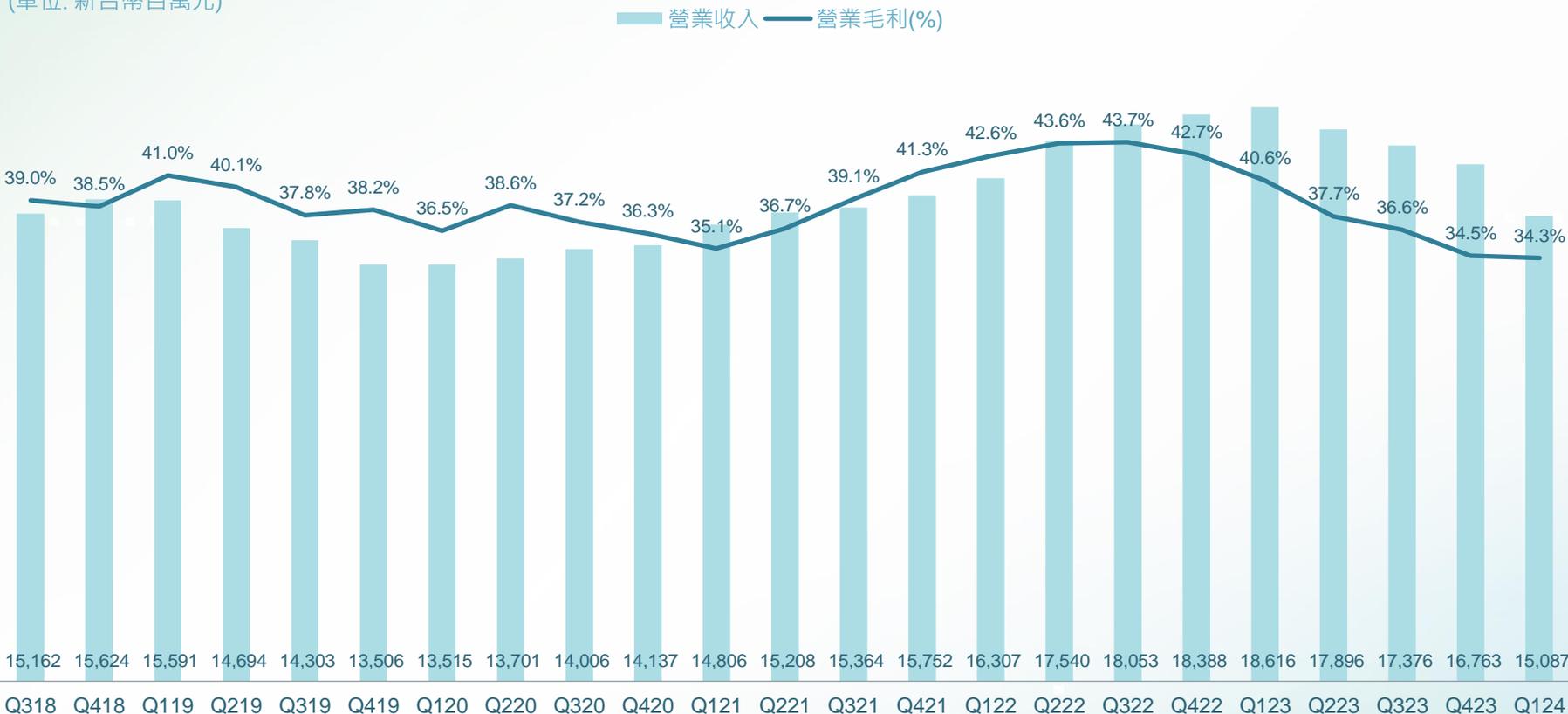
1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量
2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用
3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息
4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益
5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產
6. Capex = 期末固定資產 - 期初固定資產 + 折舊



營業收入和毛利率 (%)

營業收入和營業毛利率 (%)

(單位: 新台幣百萬元)



備註:

1. 2024年第一季毛利率下降: 主因折舊費用及擴廠費用增加所致



EBITDA和每股盈餘

EBITDA

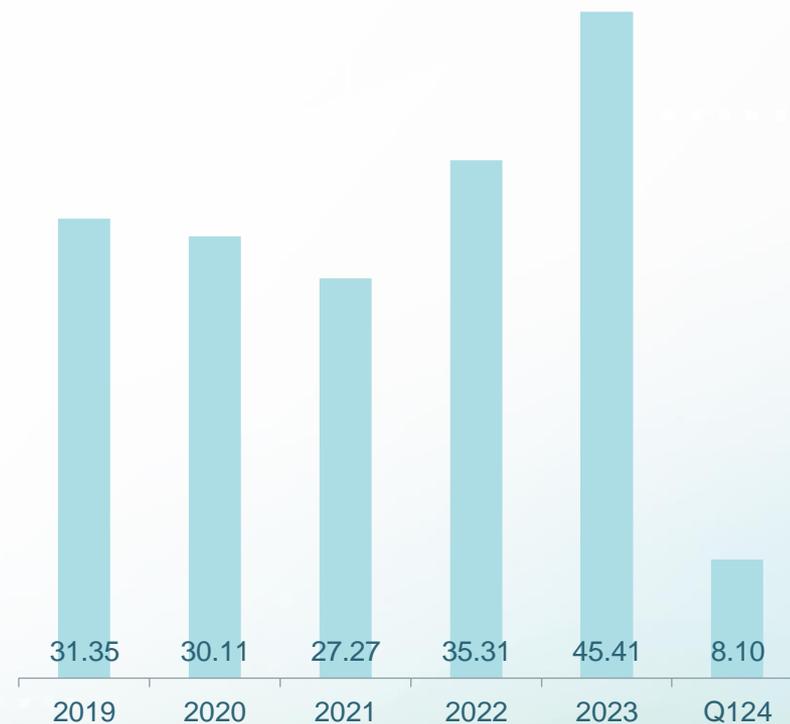
(單位: 新台幣百萬元)

■ EBITDA — EBITDA / 營業收入



每股盈餘

(單位: 新台幣元)





損益表

損益表

(單位: 新台幣百萬元)

	2020	2021	2022	2023	Q124
營業收入	55,359	61,131	70,287	70,651	15,087
<i>成長率 (%)</i>	-4.7%	10.4%	15.0%	0.5%	-10.0% ²
營業毛利	20,568	23,286	30,342	26,441	5,168
<i>營業毛利率 (%)</i>	37.2%	38.1%	43.2%	37.4%	34.3% ³
EBITDA	21,967	22,507	25,526¹	30,630¹	5,882¹
<i>EBITDA率 (%)</i>	39.7%	36.8%	36.3%	43.4%	39.0%
營業淨利	15,287	17,693	24,983	20,059	3,968
<i>營業淨利率 (%)</i>	27.6%	28.9%	35.5%	28.4%	26.3%
稅前淨利	16,615	16,445	20,107¹	26,496¹	4,558¹
<i>稅前淨利率 (%)</i>	30.0%	26.9%	28.6%	37.5%	30.2%
稅後淨利	13,104	11,870	15,367¹	19,770¹	3,533¹
<i>稅後淨利率 (%)</i>	23.7%	19.4%	21.9%	28.0%	23.4%
每股盈餘 (NT\$)	30.11	27.27	35.31¹	45.41	8.10

備註:

1. 認列其持有之Siltronic股票評價和其他因非營運之因素等影響
2. 此為季成長率，比較對象為2023年第四季數值
3. 2024年第一季毛利降低，主因折舊及電力成本增加



資產負債表

資產負債表

(單位: 新台幣百萬元)

	2020	2021	2022	2023	Q124
資產					
現金及約當現金	22,439	65,894	83,458	26,165	35,672 ¹
應收帳款	8,037	9,118	10,160	10,116	10,061
存貨	7,208	7,295	8,535	9,359	10,737 ²
不動產、廠房及設備	37,111	33,943	39,487	72,251	82,399 ³
其他資產	20,056	34,395	30,823	71,097	63,914
資產總計	94,852	150,645	169,496	188,988	202,783
負債					
短期借款	9,871	6,264	6,544	40,000	36,630 ⁴
應付帳款	3,895	4,340	4,176	5,027	5,189
長期借款	-	45,125	42,780	14,542	29,007 ⁵
其他負債	36,930	49,284	61,672	62,966	60,436
負債總計	50,697	105,013	115,172	122,534	131,262⁶
權益總計	44,155	45,632	54,324	66,454⁷	71,521⁷

現金資產細項包含:

(單位: 新台幣百萬元)

	Q124
三個月以上定存	23,665
受限制現金	11,259

備註:

- 2024年第一季現金及約當現金增加: 主係因發行海外附認股權公司債所致
- 2024年第一季存貨增加: 主係因原料增加所致
- 2024年第一季固定資產增加: 主係因新廠和舊廠擴建所致
- 2024年第一季短期借款減少: 主係因償還短期借款所致
- 2024年第一季長期貸款增加: 主係因發行海外附認股權公司債和公司債所致
- 2024年第一季總負債增加: 主係因發行海外附認股權公司債所致
- 2024年第一季股東權益增加: 主係因受保留盈餘增加與累計換算調整數影響所致



04

Q&A



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司



Thank You



Learn More on
Our Website